



# 材料・環境委員会主催 2024年度第1回公開研究会

主催：材料・環境委員会

## ◆公開研究会のご案内

### 研究会テーマ「台湾工業技術研究院ITRIの実装材料特集(仮名)」

工業技術研究院(ITRI)は1973年に設立された台湾最大規模の応用研究機関であり、技術の研究開発を通じて産業の発展を促進し、経済的価値を創出するとともに、社会福祉の向上に努めます。ITRIは産業に必要な技術開発に注力し、新興産業の発展にも力を入れます。材料化工研究所(MCL)は、ITRI最大規模の基盤研究所であり、産業のニーズを中心に据え、産業界との連携を強化しています。

また、特用化学品および材料の研究開発に資源を集中させています。今回のセミナーでは、材化所における半導体および電子パッケージ分野での技術開発と成果、ならびにITRI産業サービスセンターによるスタートアップ事業支援についてを核心テーマとしています。

開催日時 2025年2月20日(木) 13:10~15:25

開催方式 WEB開催 (Zoom Webinar使用)

ご発表は英語となります。質疑応答には日本語通訳が行います。

※参加URL等の聴講情報は、申込受付時のメールにてご連絡致します。

13:10~13:15

オープニング

開会挨拶 材料・環境技術委員会 委員長 坂本 浩捷

13:15~13:35

講演①「材料化工研究所の紹介」

工業技術研究院・材料化工研究所

吳正宇(Cheng-Yu Wu)様【英語プレゼン】

<概要>工業技術研究院・材料化工研究所は持続可能な技術と次世代ICT技術といった未来の技術発展のトレンドに基づき、さまざまな先端材料および化学の基盤技術の研究開発に取り組んでいます。また、産業界における革新的な研究開発技術の重要なパートナーとしての役割を果たしています。今回のご紹介では、材料化工研究所が注力している研究分野や研究開発成果に加え、産業界、学術界、研究機関との連携方法やその進め方について詳しく説明いたします。

13:35~13:55

講演②「高周波対応パッケージ用の重要材料および検証技術」

工業技術研究院・材料化工研究所

林志浩(Chih-Hao Lin)様【英語プレゼン】

<概要>高周波通信デバイスのパッケージングで使用された新しい樹脂について構造設計および製造、配合特性、コンポーネントの加工性と信頼性評価について紹介します。

13:55~14:15

講演③「低損失樹脂および基板材料の検証プラットフォーム」

工業技術研究院・材料化工研究所

朱晏頤(Yen-Yi Chu)様【英語プレゼン】

<概要>

低損失樹脂と銅張積層板技術、および検証プラットフォームについてご紹介します。主に、低誘電損失基板用材料の開発状況について説明し、またITRIが企業の材料開発を支援し、材料の加工性や応用可能性を検証するために使用するITRIの検証プラットフォームについてご紹介します。

(休憩10分)

14:25～14:45

講演④ 「ALDプリカーサーにおける半導体応用」

工業技術研究院・材料化工研究所 包郁傑(Pao Yu-Chieh)様【英語プレゼン】

<概要>

工業技術研究院・化工研究所における半導体先進プロセス用配線材料のALDプリカーサー開発成果について紹介します。

14:45～15:05

講演⑤ 「ハイテク工場の水処理における低炭素と資源循環利用技術」

工業技術研究院・材料化工研究所 張冠甫(Kuan-Foo Chang)様【英語プレゼン】

<概要>

水と廃水処理は、ハイテク産業において非常に重要な役割を担っています。これらの処理プロセスでは、塩酸(HCl)、水酸化ナトリウム(NaOH)、塩化カルシウム(CaCl<sub>2</sub>)などの様々な化学薬品の使用と、大量の電力が必要となります。今回では、膜分離技術と嫌気性生物処理技術について紹介するとともに、水および廃水処理施設が段階的にカーボンニュートラルを達成するための統合的なソリューションを提案します。

15:05～15:25

講演⑥ 「スタートアップエコシステムのキーパートナー・ITRI産業サービスセンターの役割と機会」

工業技術研究院・産業サービスセンター 何明豊(Ming-Feng Ho)様【英語プレゼン】

<概要>

ITRI産業サービスセンターがスタートアップエコシステムのキーパートナーとして、技術サポート、資源の統合および業界との連携を通じて、新創企業がボトルネックを突破し、成長を加速させ、国際市場に進出するための支援について焦点を当てます。

※プログラムは変更になることがありますので、ご了承ください。

定員 回路会館地下1F会議室:50名(先着申込順 定員になり次第締め切ります)  
WEB (Zoom Webinar): 200名(先着申込順 定員になり次第締め切ります)

#### 参加費(消費税込み)

正会員:5,000円、学生会員:1,000円、研究会会員:別払い、シニア会員:2,000円  
名誉会員:無料、賛助会員の社員:5,000円、賛助会員(クーポン利用):無料  
非会員一般:10,000円、非会員学生:2,000円、協賛団体会員:5,000円

#### 注意事項(参加方法)

- ①申込が受理されますと、**返信メールで公開研究会への参加 URLやお支払いに関する情報**をご連絡致します。
  - ②ご申請の手順に従って、参加費のお支払いをお願い致します。  
(お支払い方法:クレジットカード決済またはコンビニ決済のみ)(手数料学会負担)
  - ③**領収書(宛名会社名選択可)**のご発行は、返信メールのマイページから**決済後に即日出力が可能**です。
  - ④WEBの領収書が原紙扱いになりますので、ご了承ください。
  - ⑤賛助・特別クーポンは、1枚/1口まで(複数口の場合は口数分)利用可能です。申込時にクーポン番号等の全項目を記入しないと、利用できません。※複数枚使用希望がある場合はお問い合わせください。
- \* キャンセルポリシー  
お申込み後のキャンセルはできません。

**下記から参加申し込みをお願いします。**

会員

賛助会員

協賛会員

非会員

※クーポン使用の場合は「クーポン利用」をご選択ください。

問い合わせ先 一般社団法人エレクトロニクス実装学会  
E-mail: info¥jiep.or.jp (メールアドレスは¥を@に置き換えてください)

#### 協賛団体

(一社)日本電子回路工業会